

2023年12月6日

三井化学株式会社

三井化学グループ、「SEMICON[®]JAPAN 2023」に出展

三井化学株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本修）および三井化学東セロ株式会社（本社：東京都千代田区、社長：松坂 繁治）は、2023年12月13日から15日に東京ビッグサイトで開催される「SEMICON[®]JAPAN 2023」に三井化学グループとして出展いたします。

ブース内では、世界シェア No.1 のイクロステーブ[™]や三井ペリクル[™]、AR グラス用光学樹脂ウエハ Diffra[™]（ディフラ[™]）、空中ディスプレイ等の展示、半導体のロードマップを見据えた新しい技術やソリューションの提案をいたします。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。



【展示会概要】

展示会名: SEMICON[®]JAPAN 2023

開催期間: 2023年12月13日（水）～15日（金）10:00～17:00

会場: 東京ビッグサイト（東京国際展示場）東展示棟 1-8 ホール

三井化学グループブース 2513（東2ホール）（三井化学・三井化学東セロ共同ブース）

*ご来場の際は、SEMICON[®] Japan 公式サイトより事前登録をお願いいたします。

<https://www.semiconjapan.org/jp/about/pricing-and-register>

【三井化学グループ出展内容】

展示テーマ (ソリューション・製品)	担当部署
三井ペリカル™	三井化学 (株) ICT ソリューション事業本部 半導体・光学材料事業部
ハイブリッド接合向け低温接合材	三井化学 (株) ICT ソリューション事業本部 ICT 材料事業推進室
半導体パッケージテスト用異方導電性コンタクトシート	
DA 材	
液状仮固定材料『PIVAR®』	
新開発品 AR グラス用光学樹脂ウエハ 『Diffra™ (ディフラ™) 』	
イクロステープ™ (熱自己剥離粘着テープ、耐熱凸凹吸収テープ、耐熱ダイシングテープ、スーパークリーン BG テープ)	三井化学東セロ (株) プロテクトフィルム事業部
半導体封止工程用 非フッ素離型フィルム『MintRow™』	
空中ディスプレイ	三井化学 (株) 新事業開発センター
フッ素系材料代替提案	三井化学 (株) ICT ソリューション事業本部 事業企画グループ

<お問い合わせ先>

三井化学株式会社

ICT ソリューション事業本部 企画管理部 TEL : 03-6880-7474

コーポレートコミュニケーション部 TEL : 03-6880-7500

お問合せフォーム https://form.mitsuichemicals.com/corporate/cc_pr_csr_ja